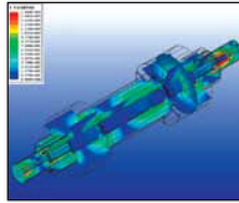
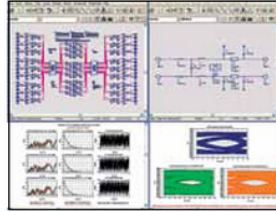
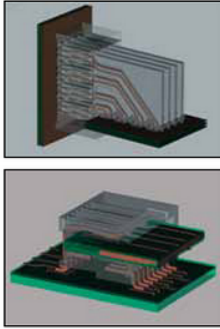


### 信号完整性的TE

TE连接获得最佳性能连接器的应用系统级的信号完整性设计专长，每个高速产品。我们的建模和仿真能力是首屈一指的，在美国，欧洲和亚洲的全球专业知识和。我们的全球业务的地方仿真，建模和系统布局专家旁边的顾客。

### 建模与仿真

在TE的设计过程开始的信号完整性。信号完整性工程师使用先进的3D工具，以提供准确的连接器和足迹通过之前的生产模式的性能。TE拥有的工具和专业知识和，以得到正确的答案。

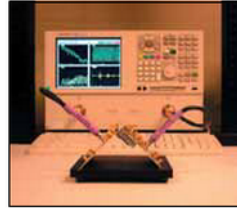


- n ANSYS HFSS和CST微波工作室全波3D工具
- n 这两种连接器和足迹通过图案（多个）分析生产前
- n S参数和SPICE分析
- n 先进的ADS和MATLAB的系统分析

### 测试能力

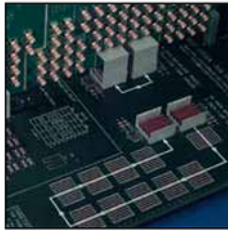
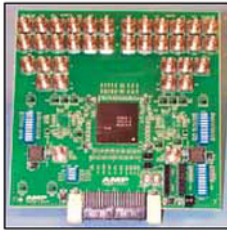
凭借超越12.5 Gbps和50 GHz的测量能力，TE可以表征，并提供详细的测量产品。新锐计量校准技术和电路板设计能精确去嵌入测试夹具。TE还联手众多硅的COM panies提供有源器件测量，可以是有价的，以保证成功实施的设计。

- n 先进的校准技术，反嵌夹具
- n 频域的50 GHz的
- n 时域眼图/ BERT到12.5 Gbps
- n 活性硅测试 - 多个供应商2 - 10+ Gbps的
- n 系统和“连接器只有”板

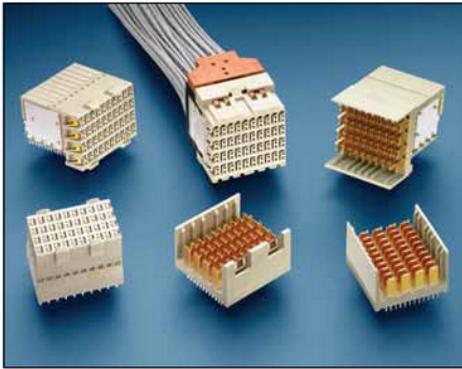


### 客户支持和工具

从测试板仿真模型，TE提供工具，帮助您成功实现您的系统库。请求可以通过我们的信号完整性的网站很容易做：[www.te.com/documentation/electrical-models](http://www.te.com/documentation/electrical-models)



- n ANSYS HFSS和CST微波工作室全波3D工具
- n 通过模式（S）两个连接器和足迹前分析生产
- n S参数和SPICE分析
- n 先进的ADS和MATLAB的系统分析
- n 基于测量S参数接口模型（64+端口）
- n 造型基础S参数接口模型（64+端口）
- n 通过模式S参数和SPICE模型的足迹
- n SPICE模型连接器
- n 连接器评估测试板
- n 系统测试板



#### Z- PACK HM -ZD和HM -ZD连接器加

- n 高达12.5 Gb / s的性能
- n 密度高达每平方厘米16个差分对（每英寸40 DP），在25.4毫米（1"）槽间距
- n 可在2，3和4对/列，配件20.32毫米（0.8"）插槽间距为2和3对版本和25.4毫米（1"）插槽间距为4对版本
- n HM -ZD加上在设计中提供增强的信号完整性倒退与标准的HM -ZD兼容
- n 先进的差分面料（ADF）在PICMG 3.X指定连接器高级TCA规格
- n 见后面板上有代表性的部件号
- n 索取产品目录1773095，"High高速背板Connector"
- n 网址：<http://hmzd.te.com>



#### Z-PACK HS3连接器

- n 高达6.25 Gb / s的性能
- n 每平方厘米的电路板空间密度可达40高速信号线（20 DP），在25.4毫米（1"）槽间距
- n 提供2个版本：6行和10列，分别拟合20.32毫米（0.8"）和25.40毫米（1"）槽间距
- n 高速连接器设计用于单端和差分信号的
- n 见后面板上有代表性的部件号
- n 索取产品目录1773095，"High高速背板Connector"
- n 网址：<http://hs3.te.com>